

2026年3月期 第1四半期 決算説明

芝浦メカトロニクス株式会社

2025年8月6日

業績サマリー

■ 売上高・利益

➤ 前年比 増収増益

売上高 215億円（26%増）、営業利益 40.6億円（32%増）

SPE分野が増加、特に半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増加。

■ 受注高

➤ 前年比 減少、QoQ 増加

受注高179億円（前年比16%減、4Q比 18%増）

半導体前工程は、前年好調であったロジック/ファウンドリ向け装置が減少。2Q以降回復基調。

半導体後工程は、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調に推移。

■ 受注残高

➤ 2025年6月末 450億円

■ 業績予想

➤ 通期業績予想は前回予想から変更なし

2025/1Q 実績 (1)

業績結果（対前年）

（単位：億円）

	2024				2025	対前年 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
売上高	171	193	202	243	215	+26%
営業利益	30.7	26.8	35.5	48.4	40.6	+32%
R O S	17.9%	13.9%	17.6%	19.9%	18.9%	+1.0pt
経常利益	31.4	24.1	36.3	48.0	40.7	+30%
当期純利益	22.9	18.1	28.5	33.8	28.7	+26%
受注高	213	156	176	153	179	-16%

* SPE：半導体前・後工程装置

FPD：FPD前・後工程装置

■ 売上高

前年比26%増収（171億円 ⇒ 215億円）

- SPE分野が増加、FPD分野と流通機器分野が減少、全体として増収。

■ 営業利益

前年比32%増益（30.7億円 ⇒ 40.6億円）

- SPE分野の売上増加により増益。

■ 受注高

前年比16%減少（213億円 ⇒ 179億円）

- 半導体前工程は、高水準であった前年に比べ減少。2Q以降回復基調。
半導体後工程は、引き続き好調に推移。

2025/1Q 実績 (2)

セグメント別業績結果（対前年）①

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

➤ 売上高 前年比21%増（106億円 ⇒ 128億円）

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向け装置が順調に推移、Siウェーハ向け装置も堅調に推移し増加。

FPD前工程では、低調で減少。

➤ セグメント利益 前年比19%増（18.9億円 ⇒ 22.4億円）

半導体前工程の売上増加により増益。

➤ 受注高 前年比24%減（139億円 ⇒ 106億円）

半導体前工程では、前年好調であったロジック/ファウンドリ向け装置が減少。2Q以降回復基調。

FPD前工程では、前年に比べ増加したものの、引き続き市況の影響を受け低調に推移。

2025/1Q 実績 (3)

セグメント別業績結果（対前年）②

■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

➤ 売上高 前年比66%増（45億円 ⇒ 74億円）

半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調で大幅に増加。
FPD後工程及び真空応用装置では、前年と同等。

➤ セグメント利益 前年比124%増（8.3億円 ⇒ 18.6億円）

半導体後工程の売上増加により大幅増益。

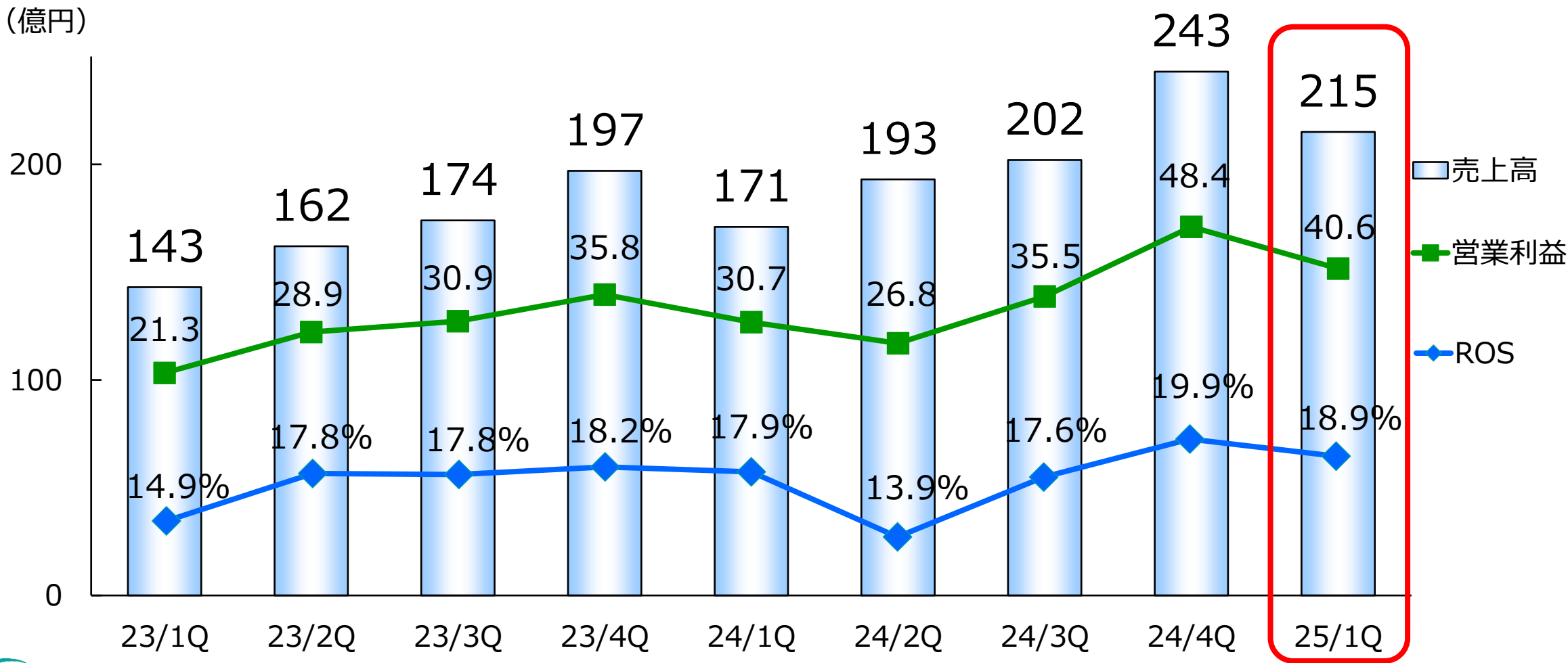
➤ 受注高 前年比13%増（53億円 ⇒ 60億円）

半導体後工程では、生成AI用GPUの需要増に伴い、先端パッケージ向け装置が好調に推移。
FPD後工程及び真空応用装置では、市況の影響を受け低調に推移。

2025/1Q 実績 (4)

売上高・利益・ROS

ROS18.9%

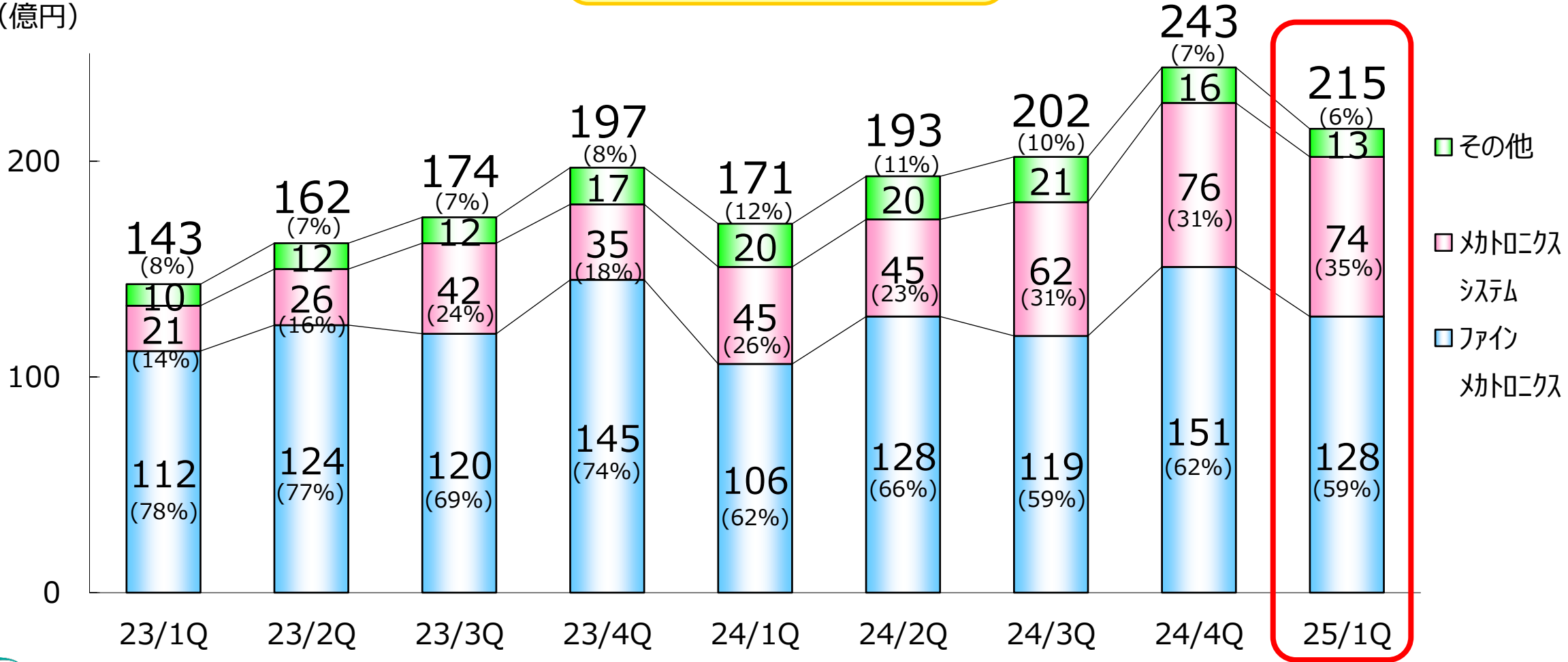


2025/1Q 実績 (5)

セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 59%
メカトロニクスシステム 35%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



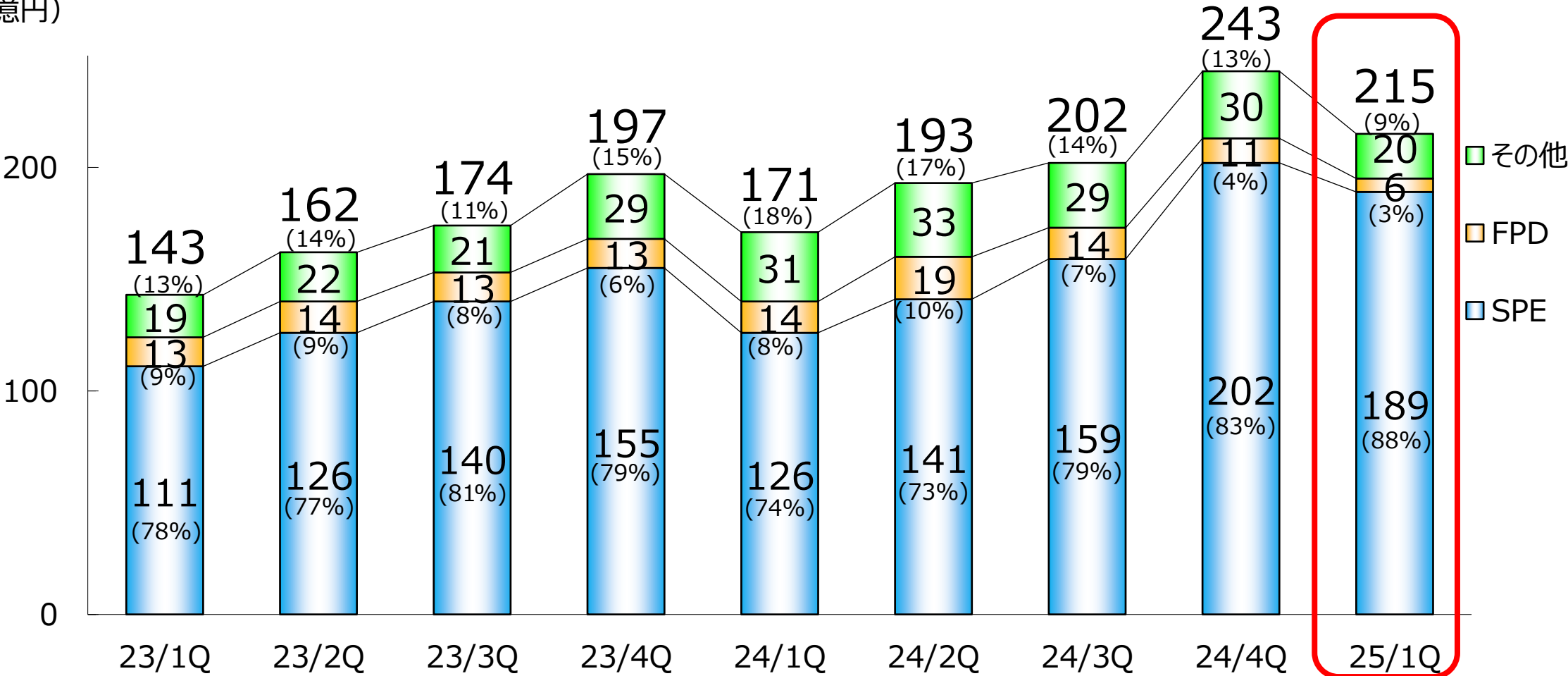
2025/1Q 実績 (6)

分野別売上高

SPE分野 88%

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

(億円)

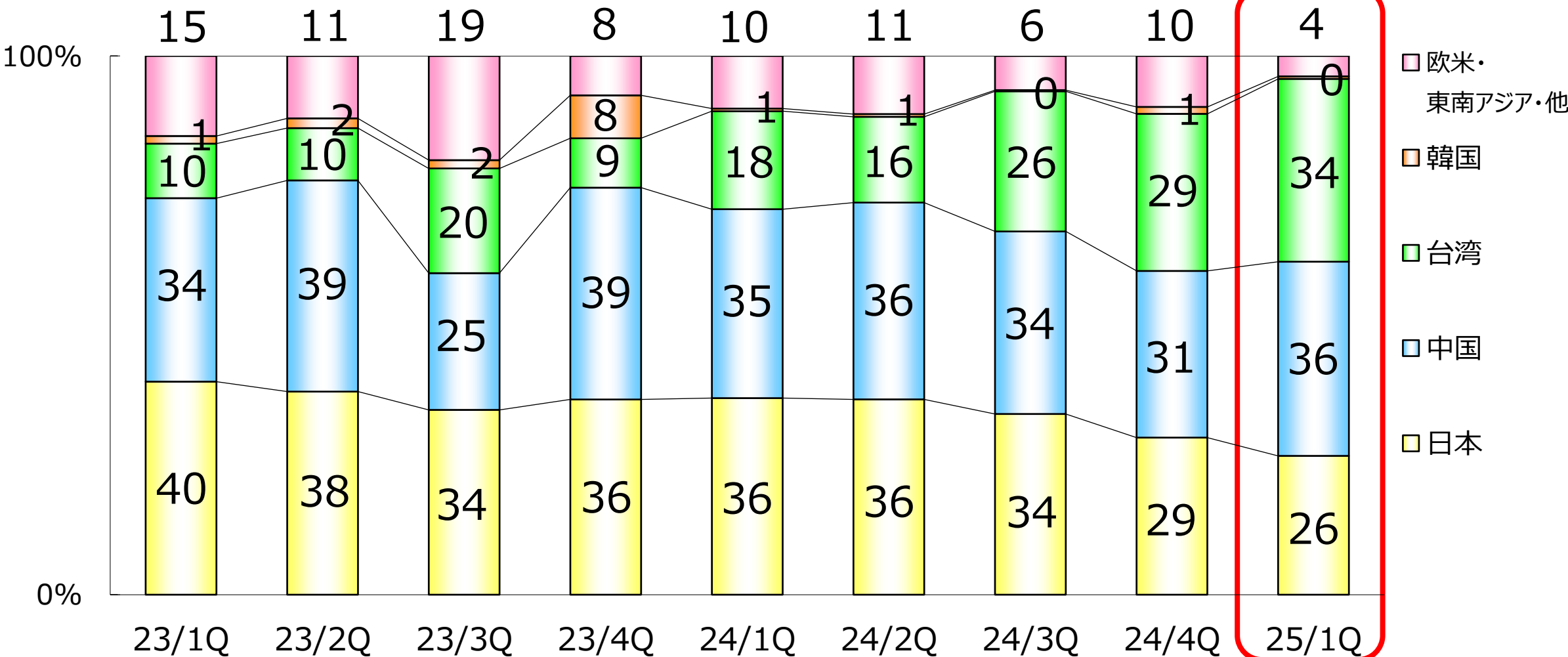


2025/1Q 実績 (7)

地域別売上高比率

海外向け74%（中国36%、台湾34%）

* 仕向地で区分



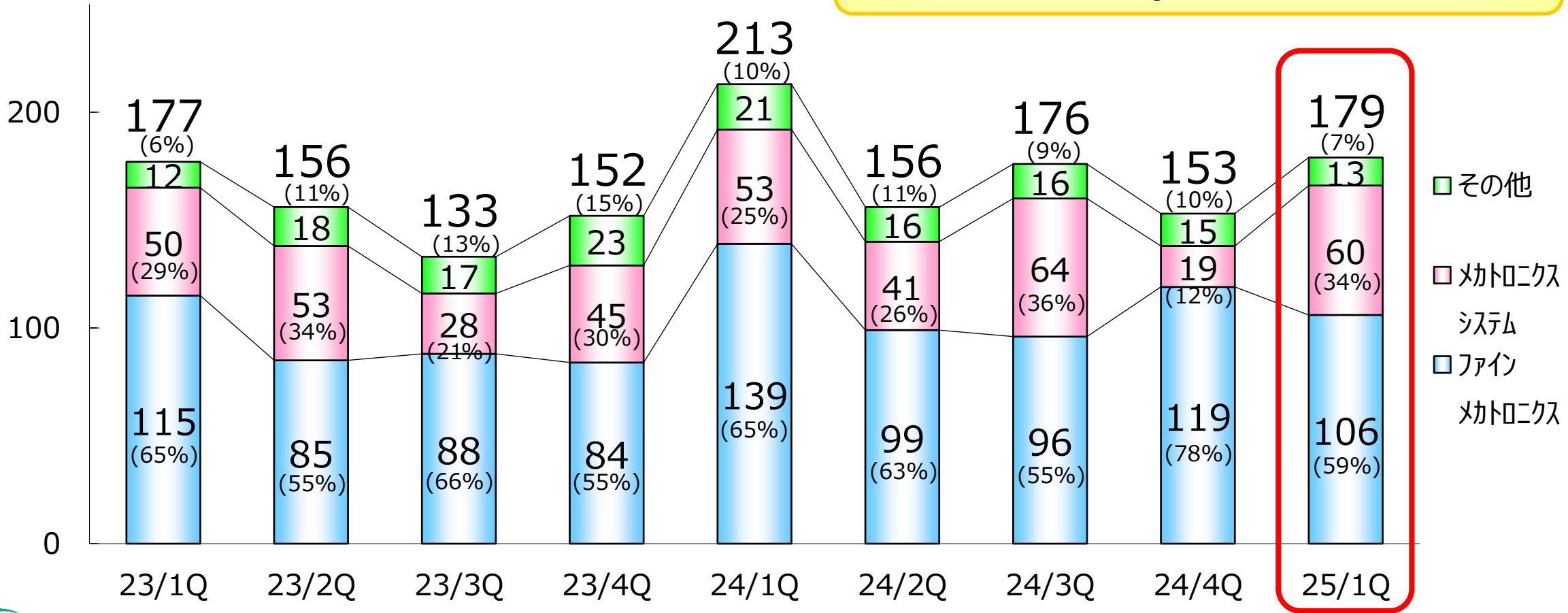
2025/1Q 実績 (8)

セグメント別受注高

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置
エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

半導体後工程の先端パッケージ向け装置が好調、
24/4Q比 受注増加

(億円)



2025/1Q 実績 (9)

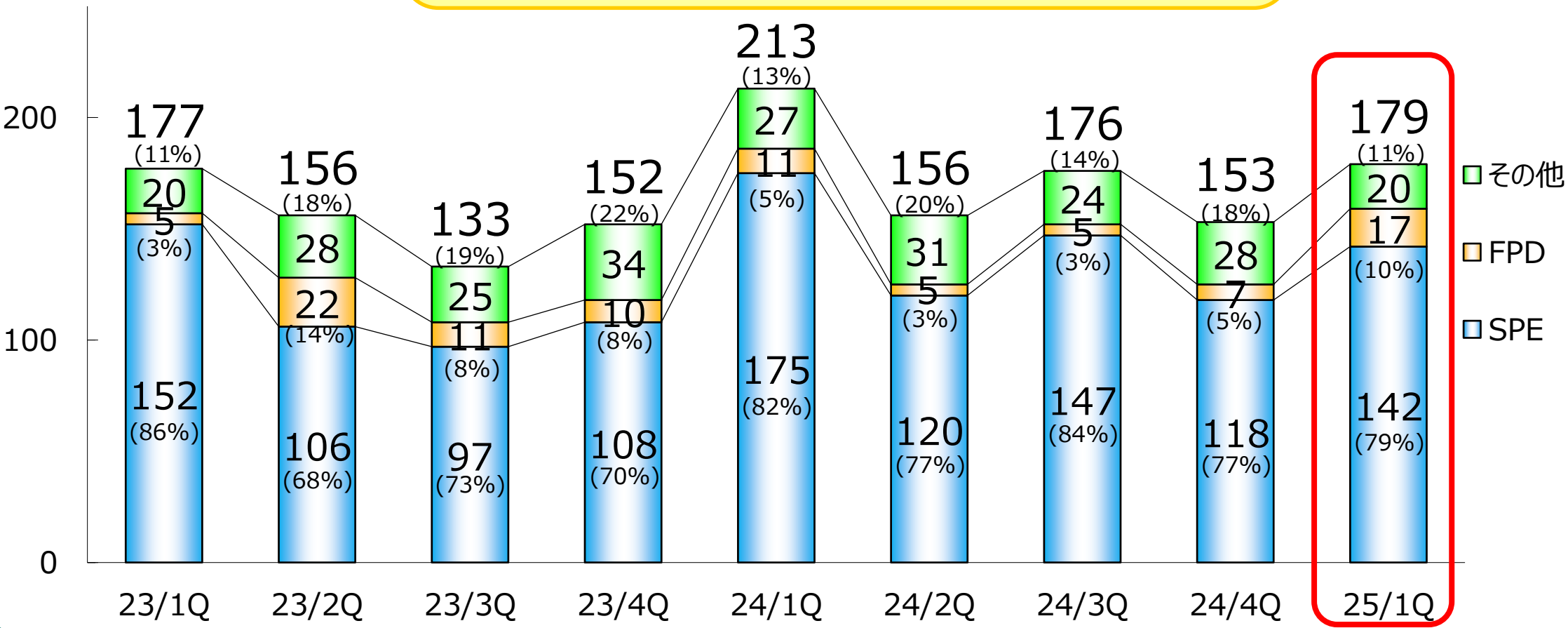
分野別受注高

(億円)

今後に向けての受注見通し

- ・先端パッケージ向け装置 : 生成AI用GPU用途中心に引き続き受注好調
- ・枚葉式リン酸エッチング装置 : 新規引き合い増加中、今後の需要拡大に期待
- ・枚葉式Siウェーハ洗浄装置 : 一定の引き合い継続、年度後半の回復に期待
- ・マスク向け装置 : エッチング装置、洗浄装置とも引き合い増加

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

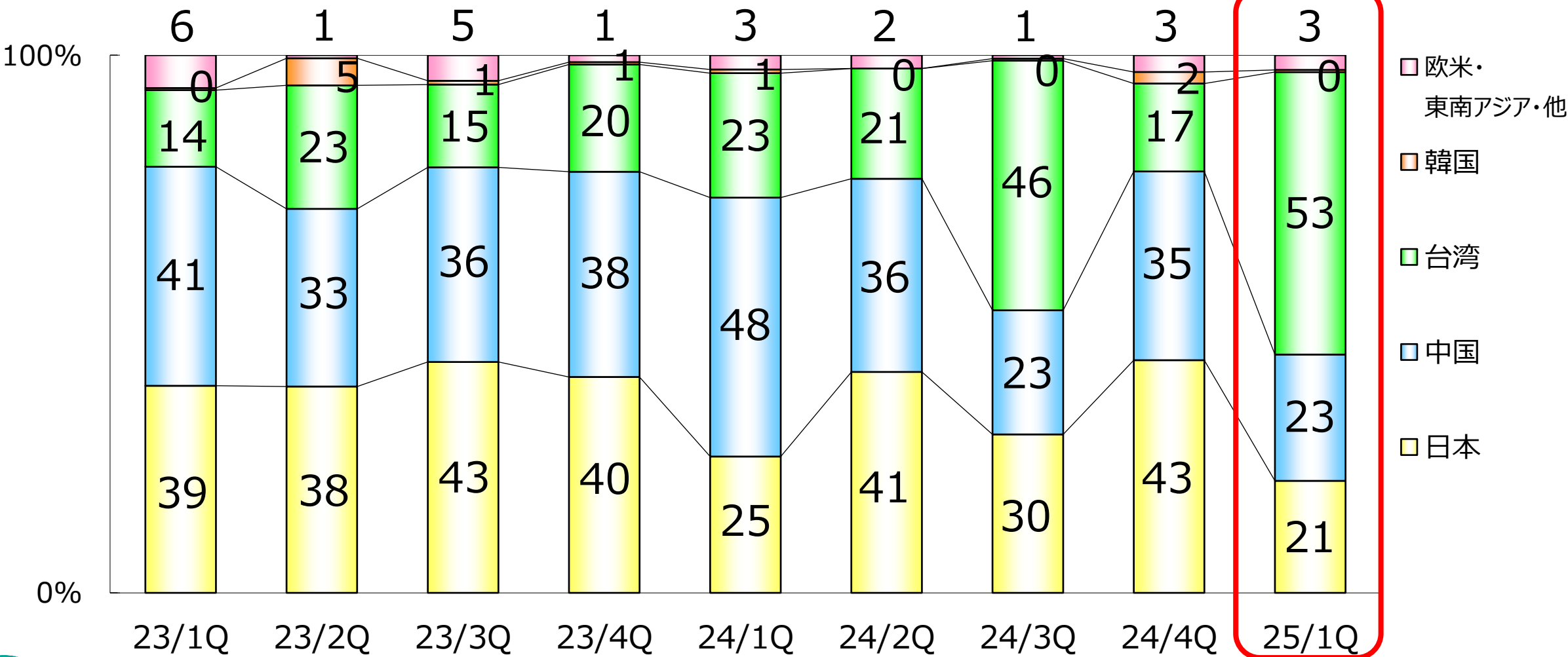


2025/1Q 実績 (10)

地域別受注高比率

海外向け79%（台湾53%、中国23%）

* 仕向地で区分

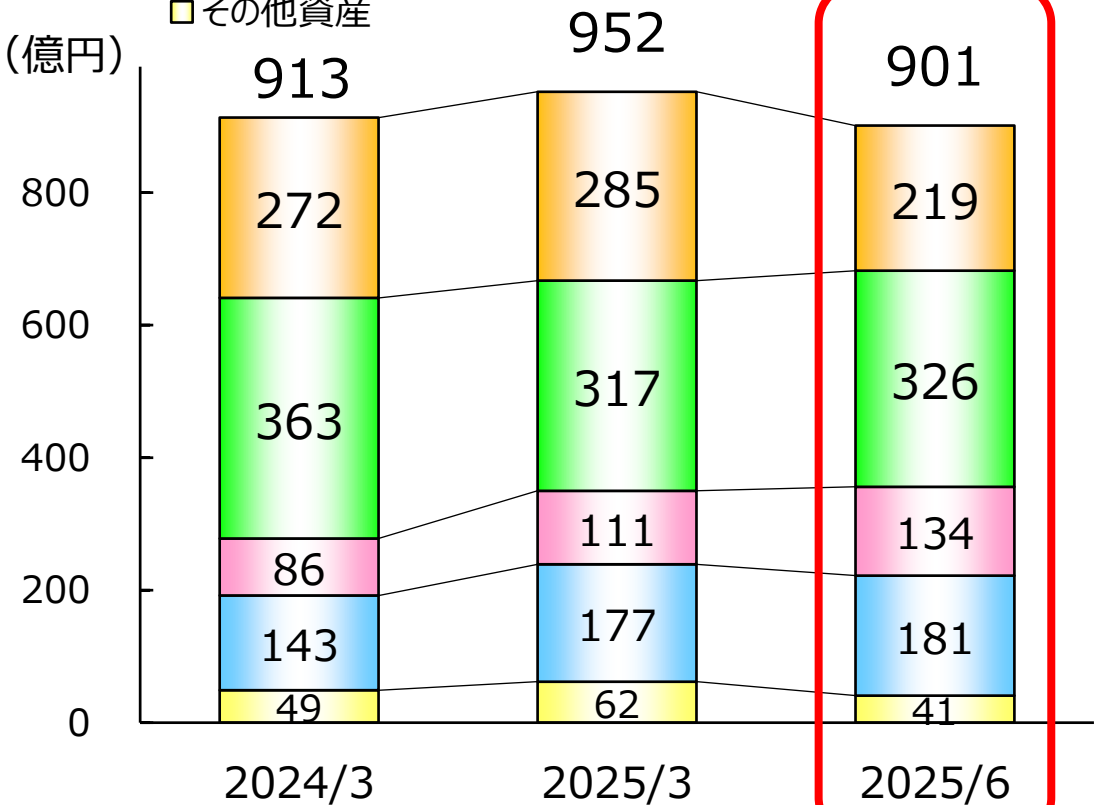


2025/1Q 実績 (11)

貸借対照表

- 現金・預金
- 売上債権
- 棚卸資産
- 有形固定資産
- その他資産

資産

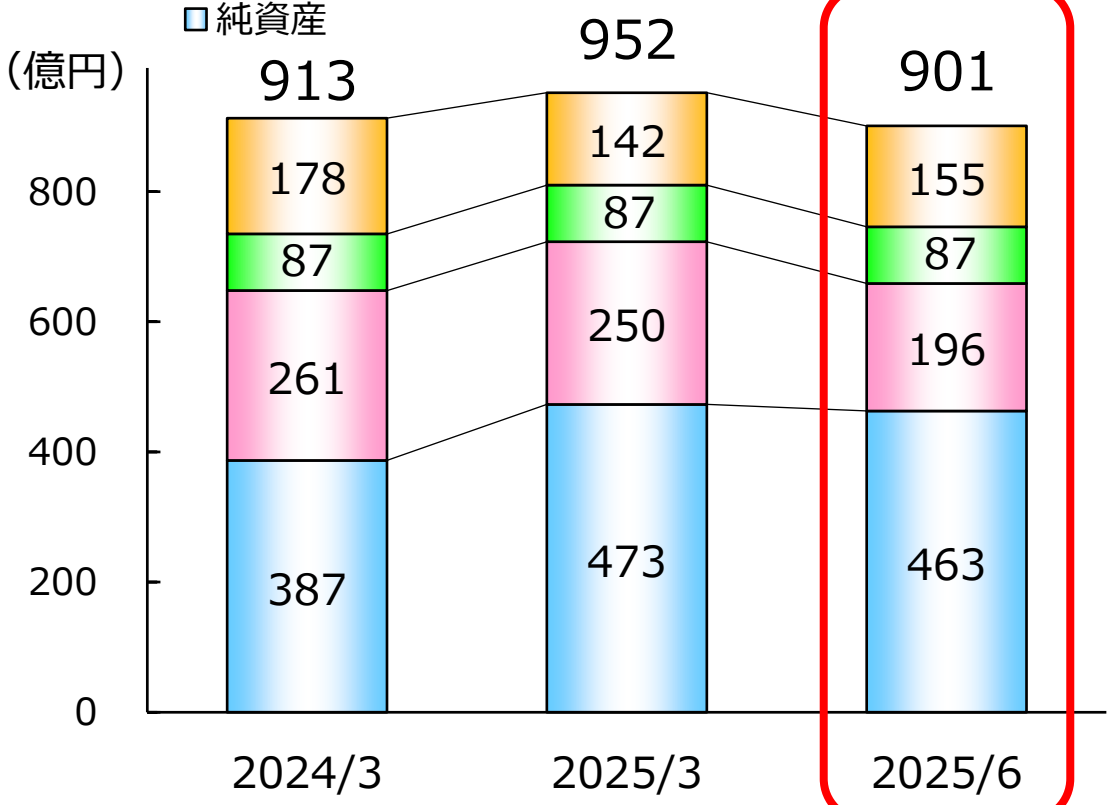


自己資本比率 50% ('25/3) → 51% ('25/6)

D/Eレシオ 0.19倍 ('25/3) → 0.19倍 ('25/6)

- 買入債務
- 借入金 (長期・短期)
- その他負債
- 純資産

負債および純資産



2025年度 業績予想

業績予想

前回予想から通期業績予想変更なし

(単位：億円)

	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度予想
売上高	493	610	676	809	800
営業利益	50.5	109.1	116.9	141.4	105.0
R O S	10.3%	17.9%	17.3%	17.5%	13.1%
経常利益	48.8	105.1	116.1	139.8	101.0
当期純利益	29.8	92.0	87.9	103.3	75.0
R O E	12.8%	31.9%	24.5%	24.0%	15.8%
F C F	77.9	32.0	36.8	37.7	6.0

トピックス

* GNT：現中期経営計画
グローバル ニッチトップ
対象製品群

- グローバルニッチトップ対象製品群の売上順調
SPE売上高 189億円の内、GNT 140億円（74%）で推移
- 先端パッケージ向け装置：生成AI用GPU用途中心に引き続き受注好調
- 先端パッケージ向けPLP用途のウェット処理装置：新規上市に向け開発継続中
- 枚葉式リン酸エッチング装置：新規引き合い増加中、今後の需要拡大に期待
- 枚葉式Siウェーハ洗浄装置：一定の引き合い継続、年度後半の回復に期待
- マスク向け装置：エッチング装置、洗浄装置とも引き合い増加

【ご参考：当社ホームページ】
＜[半導体製造装置](#) | 芝浦メカトロニクス株式会社＞



この先もずっと、 人と技術で 社会を支える。

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

芝浦メカトロニクスグループは、
「Smart」、「Solutions」、「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、
豊かな社会の実現を支えてまいります。

見通しに関する注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。